文章编号: 0253-2239(2009)Supplement 1-0242-05

一种紫外焦平面探测器电流响应率测试方法

邵秀梅^{1,2} 丁洁莹¹ 陈新禹¹ 张 燕¹ 方家熊¹ (¹中国科学院上海技术物理研究所传感技术国家重点实验室,上海 200083) ²中国科学院研究生院,北京 100049

摘要 电流响应率是紫外探测器的重要特性参数,光敏芯片与读出电路芯片耦合成焦平面组件后,不能通过测试 焦平面组件直接得到电流响应率参数。对 128×1 电容反馈互阻抗放大器(CTIA)读出电路芯片进行了系统的测 试,得到了读出电路的积分电容、源随器增益。同时,采用自研的紫外探测器高精度定标测试系统,分别对 128×1 铝镓氮(AlGaN)紫外探测器光敏芯片、128×1 紫外焦平面探测器组件进行测试,求得了从焦平面探测器推算电流 响应率的方法。结果表明,直接标定光敏芯片的电流响应率与测试焦平面组件间接推算的电流响应率基本一致, 相对偏差约 5%。该方法简便、准确,可以为综合评价紫外焦平面探测器的性能提供重要参数。

关键词 探测器;紫外焦平面;测试;电流响应率

中图分类号 O434 文献标识码 A doi: 10.3788/AOS200929s1.0242

A Test Method for Current Responsivity of UV FPA Detector

Shao Xiumei^{1,2} Ding Jieying¹ Chen Xinyu¹ Zhang Yan¹ Fang Jiaxiong¹
¹ State Key Laboratories of Transducer Technology, Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai, 200083, China
² Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100049, China

Abstract Current responsivity is an important characteristic of UV detector which cannot be measured directly after the coupling between detector array and readout integrated circuit (ROIC) chip. It's very significant on the measurement for current responsivity of UV Focal plane array (FPA) detector. The 128×1 ROIC chip were measured. The integration capacitance and gain of source follower of ROIC chip were analyzed. Then, 128×1 AlGaN photosensitive chip and 128×1 UV FPA detector were tested by using a special system which was developed independently for high-accuracy measurement of UV detector. An indirect test method for current resposivity of UV FPA detector was studied and set up. The current responsivities by testing photosensitive chip directly were basically consistent with those by testing UV FPA indirectly. The relative deviation is about 5%. This test method is very easy and reliable, so can provide significant parameters to the comprehensive evaluation of UV FPA. **Key words** detectors; ultraviolet focal plane array; measurement; current responsivity

1 引 言

近年来,紫外探测在军事、民用领域的研究与应 用越来越广泛,从而促进了紫外探测器的迅速发展^[1~4]。对紫外焦平面探测器(FPA)的研制者和用 户而言,电流响应率是评价探测器性能的重要特性 参数^[5,6],光敏芯片与读出电路芯片耦合成 FPA 组 件后,不能通过测试 FPA 直接得到电流响应率参数。目前常用的方法是在读出电路与光敏芯片互连之前,对光敏芯片进行性能测试,获得的电流响应率 作为最终评价紫外 FPA 性能的参数之一。

本文采用自研的紫外探测器高精度定标测试系统,分别对 128×1 AlGaN 紫外探测器光敏芯片、

作者简介: 邵秀梅(1978-),女,博士研究生,助理研究员,主要从事紫外电学定标热释电探测器的研制、高精度紫外探测器定标测试等方面的研究。E-mail:shaoxm@mail.sitp.ac.cn

导师简介:方家熊(1939一),男,院士,研究员,主要从事光传感器方面的研究。E-mail:jxfang@mail.sitp.ac.cn

基金项目:国家自然科学基金(60708028)资助项目

128×1 电容反馈互阻抗放大器(CTIA)读出电路芯 片、128×1紫外 FPA 组件进行测试,通过测试和分 析得到了读出电路的积分电容、源随器增益,研究直 接测试 FPA 组件性能间接得到其电流响应率的方 法,对紫外 FPA 的性能评价和使用具有积极意义。

2 原理分析

本文研究的紫外探测器光敏芯片是 128×1 背 照射铝镓氮(AlGaN)线列光伏器件,像元的光敏面 尺寸为 200 µm×85 µm,像元中心距为 100 µm,光 敏芯片与宝石过渡电极板通过铟柱倒焊互连。 128×1 CMOS 读出电路输入级采用的是电容反馈 互阻抗放大器(CTIA)结构^[7],输出级为源随器结 构,采用相关双采样技术,两路输出。读出电路与宝 石过渡电极板通过键压互连,从而实现光敏芯片与 读出电路的耦合,组件采用双列直插金属管壳封装, 无窗口。

文中采用的 CTIA 型读出电路,当光敏元接收 光信号并产生与信号值相关的电荷,光电流积累在 积分电容上,积分电容的输入端与光敏元相连并保 持恒定,输出端的电压随着积分过程的进行而线性 下降。积分时间结束后进行采样并通过多路开关采 样保持,信号电压为参考电压与积分后采样电压的 差值,保持的信号最终由源随器输出,光电流 I_{det} 可 以按照下式推算^[8]:

$$I_{\text{det}} = \frac{V_{\text{out}} \cdot (C_{\text{int}} + \frac{C_{\text{int}} + C_{\text{det}}}{A_{v_op}})}{A_v \cdot T_{\text{int}}}, \qquad (1)$$

式中 V_{out} 为 FPA 的信号电压, C_{int} 为电路积分电容, C_{det} 为探测器寄生电容, $A_{v_{op}}$ 为运放的电压增益, T_{int} 为积分时间, A_v 为电路源随器增益。一般情况下,运放的电压增益 $A_{v_{op}} \gg 1000$,(1)式可以简化为

$$I_{\rm det} = \frac{V_{\rm out} \cdot C_{\rm int}}{A_v \cdot T_{\rm int}},\tag{2}$$

其中 A_v和 C_{int}可以通过实际测试确定,再测试 FPA 的信号电压,即可通过(2)式计算光电流。结合紫外 辐射功率的定标,得到 FPA 的电流响应率。

3 读出电路测试

3.1 读出电路源随器增益

采用图1所示的系统对读出电路进行测试。源

随器在线性段的电压增益 A_v 为输出电压 V_{out} 与输 入电压 V_{in} 的比值^[9]。由于读出电路为集成电路, 源随器的输入端没有芯片片外引脚,无法直接将电 压加载到输入端。实际测试中将参考电压 V_{ref} 加载 到运放的正输入端,根据运放的输入虚地原理,其正 输入端和负输入端电压在正常工作区间内相同,通 过调整外加的控制电压,使加载到源随器的 V_{in} 与 外加的 V_{ref} 相同。根据在不同 V_{ref}条件下 V_{out} 的输 出,可以计算得到源随器的增益:

$$A_v = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{V_{\text{out1}} - V_{\text{out2}}}{V_{\text{ref}}},$$
(3)

式中Vout2 即为参考电压Vref。





在实际测试中,改变 V_{ref} 数值,采集输出电压 V_{outl} ,在线性区间内进拟合,得到的曲线斜率即为 源随器的增益。随机挑选了 9条 128×1 读出电路, 按照以上的测试方法进行测试。图 2为编号分别为 ODD-T4、EVEN-T4 电路上读出单元 1、读出单元 40、读出单元 80、读出单元 120、读出单元 128 在不 同 V_{ref} 下的 V_{outl} 。

从图可见,同一条电路上不同读出单元的测试数据基本一致,因此可以计算每条电路 128 个读出单元的平均值,对于不同的 V_{ref} ,在线性区间内用最小二乘法拟合曲线的斜率,即源随器的 A_v 。以ODD-T4、EVEN-T4 电路为例,其线性区间约为 1.6~3.5 V,将 1.7~3.4 V区间内的测试数据通过 origin 软件进行拟合,其 A_v 分别为 0.78236 和 0.77665。按照同样方法测试了 7 条电路,拟合得到的结果见表 1。从表中可见,随机抽测的 9 条电路,其 A_v 基本一致,相对标准偏差仅为 0.25%,平均值为 0.779。





Fig. 2 The relationship between $V_{\rm ref}$ and $V_{\rm outl}$

表 1 读出电路源随器增益拟合结果

 Table 1 Best-fit parameters of source follower gain

 of readout integrated circuit chip

| Serial | 1 | מ | Standard |
|----------|---------|---------|-----------|
| number | R | K | deviation |
| odd-T4 | 0.78236 | 0.99992 | 0.00541 |
| odd-T1 | 0.77968 | 0.99992 | 0.00534 |
| odd-T18 | 0.77833 | 0.99992 | 0.00538 |
| even-T4 | 0.77665 | 0.99992 | 0.00552 |
| even-T1 | 0.78048 | 0.99992 | 0.00552 |
| even-T18 | 0.78037 | 0.99992 | 0.00544 |
| even-T11 | 0.77844 | 0.99992 | 0.00544 |
| even-T19 | 0.77661 | 0.99991 | 0.00563 |
| even-T20 | 0.77754 | 0.99992 | 0.00545 |

3.2 读出电路源积分电容

设计的 CTIA 读出电路积分电容为 1 pF,实际 电容由于受到流片工艺的限制,与理论设计值可能 存在一定的偏差。采用图 1 所示的系统测试电路实 际的积分电容,在运放的负端串接一个大电阻 R_{in} , 在电阻的另一端加偏压 V_{in} ,向运放的负端注入一个 微小的电流,测试 V_{out} 端的输出电压在积分时间内

148.4

的输出变化, 拟合 V_{out} 随积分时间变化的斜率 k, 按 (4) 式计算积分电容 C_{int} 。式中 V_{ref0} 为运放负极处的 实际电压。

$$C_{\rm int} = -\frac{V_{\rm in} - V_{\rm ref0}}{R_{\rm in}} \cdot \frac{A_v}{k}.$$
 (4)

随机抽取两条电路 odd-T1 和 even-T1 中的 3 个读出单元进行测试。参考电压为 2.5 V,选取 150 MΩ 左右的电阻作为串接电阻 R_{in},因为注入电流不 能太大,因此将偏压 V_{in}控制在参考电压附近。以 odd-T1电路为例,在第 74 读出单元串接电阻 152.2 MΩ,V_{in}分别设定为 2.480 V、2.540 V 和 2.599 V,测试不同 V_{in}下电路 V_{out}在积分时间内的 输出变化。在线性范围内,拟合曲线的斜率 k,代入 (4)式,即可计算得到 odd-T1-p74 电路单元在不同 V_{in}的积分电容值。按照同样的方法,测试了 even-T1电路中的 p1、p124 读出单元。三个电路单 元的积分电容见表 2 所示。可见,电路的积分电容 基本一致,相对标准偏差为 1.66%,平均值约为 1.17 pF,略高于设计值 1 pF。

| Table 2 The results of integration capacitance of readout integrated circuit circ | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|----------|----------------------|----------------------|--|
| Serial number | $R_{ m in}/{ m M}\Omega$ | $V_{ m in}/{ m V}$ | A_v | $V_{ m ref0}/{ m V}$ | $C_{ m int}/{ m PF}$ | |
| odd-T1-p74 | 152.2 | 2.599 | -422.975 | 2.503 | 1.16 | |
| odd-T1-p74 | 152.2 | 2.54 | -164.076 | 2.503 | 1.15 | |
| odd-T1-p74 | 152.2 | 2.48 | 100.429 | 2.503 | 1.17 | |
| even-T1-p1 | 150.8 | 2.599 | -433.978 | 2.502 | 1.15 | |
| even-T1-p1 | 150.8 | 2.54 | -171.191 | 2.502 | 1.15 | |
| even-T1-p1 | 150.8 | 2.48 | 98.543 | 2.502 | 1.15 | |
| even-T1-p124 | 148.4 | 2.599 | -432.701 | 2.5 | 1.20 | |
| even-T1-p124 | 148.4 | 2.54 | -173.898 | 2.501 | 1.18 | |

92.674

2.48

Table 2 The results of integration capacitance of readout intergrated circuit chip

4 UV FPA 电流响应率

4.1 光敏芯片定标测试

even-T1-p124

当通过实际测试确定读出电路的源随器增益 A。和积分电容C_{int}后,即可直接测试UVFPA,再根 据(2)式得到电流响应率。为了从实验上验证该方

2.501

1.19

法,在光敏芯片与电路芯片互连之前,先对光敏芯片 进行定标测试。采用本课题组自研的紫外探测器高 精度定标测试系统^[10,11],该测试系统的关键部件是 紫外辐射功率定标系统,通过电定标探头实现紫外 辐射功率和电学加热功率的等效,在光电等效基础 上实现紫外辐射功率的绝对定标。采用调制锁相方 式采集待测探测器的电流信号,然后通过高精度电 移平台将电定标探头移到同一光斑处,标定紫外辐 射功率,即可得到光敏芯片的电流响应率。 抽测了 3 条128×1背照射 AlGaN 线列光伏芯 片中 6 个像元,器件的光谱响应范围是 300~365 nm,在其响应峰值 360 nm 波段测试, 125-2-5 芯片和 125-2-6 芯片接收的功率密度为 0.223 W/m²,125-2-7 芯片接收的功率密度为 0.181 W/m²,结果见表 3。3 条光敏芯片的电流响 应率平均值分别为 0.101 A/W、0.100 A/W 和 0.097 A/W。

表 3 128×1 AlGaN 光敏芯片的电流响应率 Table 3 The current responsivity of 128×1 AlGaN photosensitive chip

| | Chip 125-2-5 Chip 125-2-6 | | 5 Chip 125-2-7 | | | | | |
|--------|---------------------------|-----------|----------------|-------------|-----------|--------|-------------|-----------|
| Pixels | Current /nA | Ri /(A/W) | Pixels | Current /nA | Ri /(A/W) | Pixels | Current /nA | Ri /(A/W) |
| A10 | 0.175 | 0.103 | A8 | 0.173 | 0.102 | B1 | 0.137 | 0.099 |
| A7 | 0.174 | 0.102 | A6 | 0.170 | 0.100 | B6 | 0.136 | 0.098 |
| A5 | 0.173 | 0.102 | A3 | 0.165 | 0.097 | B10 | 0.129 | 0.093 |
| A3 | 0.167 | 0.098 | B8 | 0.164 | 0.096 | A1 | 0.134 | 0.097 |
| B6 | 0.171 | 0.100 | B6 | 0.171 | 0.100 | A5 | 0.135 | 0.098 |
| B3 | 0.170 | 0.100 | B3 | 0.175 | 0.103 | A10 | 0.136 | 0.098 |

4.2 UV FPA 定标测试

将测试了的 3 条光敏芯片与读出电路互连,测试紫外 FPA 探测器的性能。同样在 360 nm,采集 3 个 FPA 的 128 元响应信号,积分时间 950 μs。扣除盲元后,计算各 FPA 的信号平均值,按照(2)式推算光电流,即得到 FPA 的平均电流响应率,见表 4。

表 4 128×1 AlGaN FPA 测试结果

| · · · |
|-------|
|-------|

| FPA number | Non-effective pixel factor/ % | Average signal / V | Irradiation power $/ (W/m^2)$ | Average current / nA | Average Ri / (A/W) |
|------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 125-2-5 | 0 | 0.2486 | 0.221 | 0.393 | 0.105 |
| 125-2-6 | 3.91 | 0.2223 | 0.221 | 0.351 | 0.094 |
| 125-2-7 | 0 | 0.1377 | 0.141 | 0.218 | 0.091 |

综合比较表 3 和表 4 的测试结果,可以发现,对 于同样的 3 条光敏芯片,在与电路互连前后的电流 响应率结果基本一致,平均电流响应率的相对偏差 分别为 3.81%、-6.81%和-6.59%。这个偏差可 能来自于以下两方面:芯片仅抽测了 6 个像元取平 均值,而 FPA 是一次采集 128 个像元信号,仅扣除 了盲元后取平均;建立的紫外探测器高精度定标测 试系统的不确定度约为 3%~5%,前后两轮测试中 存在一定的偏差也是合理的。

5 结 论

研究了直接测试紫外 FPA 性能,推算其电流响 应率的方法,并通过实验进行了验证。测试了 128×1 CTIA读出电路芯片,其源随器增益为 0.779,积分电容为 1.17 pF。分别定标测试了 128×1 AlGaN紫外探测器光敏芯片、128×1紫外 FPA 在 360 nm 波段处的电流响应率。结果表明, 3 个 FPA组件的平均电流响应率与直接标定光敏芯 片得到的平均电流响应率相比,结果基本一致,相对 偏差分别为 3.81%、-6.81%和-6.59%。鉴于同 一批电路的参数基本一致,确定了电路参数后可直 接测试 FPA 性能推算其电流响应率,简便、准确,为 综合评价 FPA 性能提供重要的评价参数。

参考文献

1 Razeghi M, Rogalski A. Semiconductor ultraviolet detectors[J]. J. Appl. Phys., 1996, 9(10): 7433~7473

- 3 Brown J D, Boney J, Mattews L. *et al.*. UV-specific(320-365 nm) digital camera based on 128×128 focal plance array of GaN/AlGaN p-i-n photodiodes [J]. *MRS Internet J. Nitride Semicond. Res.*, 2000.5(6): $1 \sim 10$
- 4 Mcclintock R, Mayes K, Yansan A, et al.. 320×256 Solarblind focal plane arrays based on Al_xGa_{1-x}N[J]. Appl. Phys. Lett., 2005, 86(1): 011~117
- 5 Wang Jun, Zhao Degang, Liu Zongshun, et al. GaN Schottky barrier ultraviolet detector [J], Chinese Journal of Semiconductors, 2004,25(6): 711~714
 王 俊,赵德刚,刘宗顺等, GaN 基肖特基结构紫外探测器[J].

土 役, 赵德刚, 刘示顺寺, GaN 基目 将基结构 案外 採测 畚 [J]. 半导体学报, 2004, 25(6): 711~714

- 6 Malachowski, Michal J., Plucinski, et al. Responsivity of GaN and (Ga, Al) N band-gap graded ultraviolet p-n detectors [C]. SPIE, 1999, 3884: 324~331
- 7 Xu Yunhua, Zhang Song, Xie Wenqing, et al.. Input circuit of

focal plane arrays [J]. Infrared and Laser Engineering , 2006.35 (5): $555{\sim}558$

- 徐运华,张 松,谢文青 等. 焦平面输入电路研究[J]. 红外与激 光工程, 2006, **35**(5): 555~558
- 8 Fossum Eric R., Pain Bedabrata. Infrared readout electronics for space science sensors: state of art and future directions [C], SPIE, 1993, 2020: 262~285
- 9 Behzad Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits[M]. Xi'an: Xi'an Jiaotong University Press, 2003: 57~63 拉扎维. 模拟 CMOS 集成电路设计[M].西安:西安交通大学出版社,2003: 57~63
- 10 Shao Xiumei, Ding Jieying, Yu Yuehua et al.. Electrically calibrated pyroelectric detector for high-accuracy calibration of UV radiation[C], SPIE, 2007, 6834: 68341E